

Title (en)

Method for producing slip ring brushes and such a produced slip ring brush

Title (de)

Verfahren zur Herstellung von Schleifringbürsten und auf diese Weise hergestellte Schleifringbürste

Title (fr)

Méthode de production de balais pour bague collectrice et un balai produit par cette méthode

Publication

EP 1453155 A2 20040901 (DE)

Application

EP 03026305 A 20031115

Priority

- DE 10309213 A 20030228
- DE 10324699 A 20030530

Abstract (en)

The slip ring brush has a circuit board (1) with opposing first and second (B) surfaces, a conducting track and a bore (1.21, 1.22) through both surfaces and a brush element (21). A connection is made between the brush element and conducting track by soldering. The method involves soldering the brush element so that the solder (3) passes from the second circuit board surface through the bore to the brush element on the first circuit board surface. An independent claim is also included for the following: (a) slip ring brushes manufactured in accordance with the inventive method.

Abstract (de)

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung einer Schleifringbürste, wobei die Schleifringbürste ein Bürstenelement (2, 21) und eine Leiterplatte (1) umfasst. Die Leiterplatte (1) hat eine erste Oberfläche (A) und eine zweite Oberfläche (B) und weist mindestens eine Leiterbahn (1.1, 1.11, 1.12) sowie mindestens eine Bohrung (1.2, 1.21, 1.22) auf, welche die Leiterplatte (1) durch die Oberfläche (A) und die Oberfläche (B) hindurch durchdringt. Es wird ein elektrischer Kontakt zwischen dem Bürstenelement (2) und der Leiterbahn (1.1, 1.11, 1.12) durch Löten hergestellt. Das Bürstenelement (2, 21) wird erfindungsgemäß in der Weise verlötet, dass das Lot (3), kommend von der zweiten Oberfläche (B) der Leiterplatte (1) durch die Bohrung (1.2, 1.21, 1.22) der Leiterplatte (1) bis hin zum Bürstenelement (2, 21) an der Oberfläche (A) hindurchtritt.

<IMAGE>

IPC 1-7

H01R 39/18

IPC 8 full level

H01R 39/24 (2006.01); **H01R 39/38** (2006.01); **H01R 43/12** (2006.01)

CPC (source: EP US)

H01R 39/24 (2013.01 - EP US); **H01R 12/57** (2013.01 - EP US); **H01R 39/383** (2013.01 - EP US); **H01R 43/12** (2013.01 - EP US); **Y10T 29/49119** (2015.01 - EP US)

Cited by

DE102012204830A1; DE102012203842B3; DE102012204829A1; DE102013204004B4; DE102013204004A1; US8986053B2; WO2013143842A1

Designated contracting state (EPC)

AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HU IE IT LI LU MC NL PT RO SE SI SK TR

DOCDB simple family (publication)

EP 1453155 A2 20040901; **EP 1453155 A3 20051026**; **EP 1453155 B1 20070307**; AT E356451 T1 20070315; DE 50306739 D1 20070419; US 2005012426 A1 20050120; US 6909217 B2 20050621

DOCDB simple family (application)

EP 03026305 A 20031115; AT 03026305 T 20031115; DE 50306739 T 20031115; US 79146304 A 20040301